月报

中兴摘要：

12.80MHz，19.44M，32.768M还在测试中，其中32.768M还在测试中，12.8M测试基本结束，19.44M在北京研发的测试有问题，即在高低温时产生的误码超标，分析下来和客户的使用环境有关，按照两种升级方案（加LDO和RC），重新各提交了各5pcs样品，测试通过。带来的影响是中兴会要求重新走测试流程。经过和王硕的沟通，请她帮忙协调，并出示质量保证的邮件。最终可以继续往下走，北京研发现准备出测试报告，之后可进行到内部流转流程。

10M 贴片OC 6月共供货375pcs，9月29日中兴反馈做了5块板子，武汉研发焊接回来以后发现有1个晶振盖子脱落，我们做了初步澄清，现在内部做测试解决这个问题。

100M用于5G测试设备的产品已经在最后的测试阶段，预计10月13日可以发货。目前客户下了5pcs的订单，只有我们一家在供。

35代码的基础测试已经结束，没有问题。由于温箱资源有限，单板10月10日和其它单板混合放入温箱，本来一周可以出结果，但其它单板要测一个月，所以，板子要11月10日才能出箱。接下来要上整机做SI和相噪测试，如果有环境的话，2天就能出结果，最后再看甘浩的DPA分析如果没有问题，那么就可以综合出报告了。

9522平台项目：

固件拿去测试，有些小问题，技术方面在沟通。和联通的测试往后推了，目前预估到10月底，11月初。18年小批量，而后9510全部要求用9522替换。

北京研发9522+O22S-10M。99E 数据中心交换机，59E单核1U交换机。板子画完，8月返板，9月中旬开始调试。年底要求完成调试。18年Q1-Q2转产。是北京今年最重要的两个项目。对我们的支持满意。

上海思源：测试在9月份完成了，产品没有问题。关于小批量试用要采购部来主导，原则上已经同意大普进入体系，但年末多出来很多新的项目（断路器、熔断器、保护设备等），研发和采购都很忙，没有时间来安排我们的小批量。这颗25M的OC年初预估7K，截止到现在采购量只有约2.5K，3月份下单到现在一直没有需求。这个项目是合并单元，由于价格太高，卖得并不好，公司也在调整方向，谋求用新的低成本的方案来替代现在的方案。未来国家电网也会有一些新的技术要求出来，届时会有一些机会的。目前的需求主要以几毛到几块的低端晶振为主。

上海瀚讯：由于军改，老项目需求锐减，也没有新项目。南京一些零星的单兵作战系统的项目，2颗物料已定型，买了几十片，同样因此军改原因没实现量产。

上海泰坦：

合并单元上之前用的是鸿晔的产品，使用的是O23封装，新项目选择我们的O22B-G445-10M产品，目前在测试中，如果没有问题，老的项目全部改为O22B的封装。EAU 400-500pcs，新项目目前不详。还有个时钟产品使用的是Crystek的T75-10M的产品，我们也在做替换，但是相噪很高，-130dbc@1K， 我们只能做到-110~ -120dbc，目前在沟通是否需要那么高的相噪。同时铷钟也有需求，我们在推R55B, 本周会做一次技术沟通。争取把所有的晶振需求全部拿下。

共进上海研发：

除老的8口MDU项目量产之外，我们还design in了共进的几个新项目。XG-24240 MDU：上海贝尔24口+4 MDU项目现处于原理图评审阶段，PCB画图已经开始，方案实现上出了点问题，下月才能完成画板，然后调试，视项目顺利程度来定进度，暂时没有进度要求。明年下半年转产。现在电信的招标即将开始，项目现在调试中，一些技术问题正在和我们协商解决。推荐9528方案。OLT: 由于共进只有终端，OLT都是搭配销售（博达，贝尔），在很多项目面前显得有点单薄，乏力，所以准备立项投入OLT，同时丰富系统集成的业务。1U OLT原理图在8月份进行了沟通，针对POL市场共进准备推进，目前是自研方案，全面自主研发，面向全球市场。计划9月布板，18年Q2转产。推荐9522+O11S方案。

上海恒为：

交换机的项目使用我们的O22B-10M，本来今年下半年要量产，预期下半年会有300pcs，可项目滞后，军方的订单一直没下来。今年已经采购了260pcs，其中下半年200pcs。

上海创远仪器：

大的测试设备一般用10M OC，量很少。小的手持式的，用T32-10M和T53-32M的，但是要求稳定度很高， 现在技术沟通阶段。南京为研发，上海有小量研发，采购口统一放在上海。上海和研发财务独立结算。

下一步工作计划：

1，中兴3颗TC认证推动，争取在年底完成，尽快转小批量；

2，中兴35代码的测试工作争取在12月份前完成，年底出内部测试报告，方可参加18年招标；

3，如上列出的客户需要深入挖掘；

4，招个本地销售。不是给人让我们挑，而是没人投简历。我会和人事再沟通。